

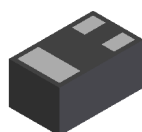
Features

- Low Collector-Emitter Saturation Voltage, $V_{CE(sat)}$
- Ultra-Small Leadless Surface Mount Package
- ESD HBM SKV MM 400V
- Complementary PNP Type Available (DSS3515M)
- "Lead Free", RoHS Compliant (Note 1)
- Halogen and Antimony Free. "Green" Device (Note 2)

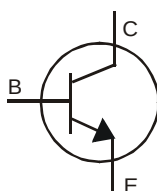
Mechanical Data

- Case: DFN1006-3
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020
- Terminals: Finish — NiPdAu over Copper leadframe. Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Weight: 0.0009 grams (Approximate)

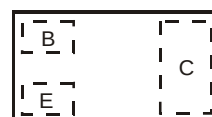
DFN1006-3



Bottom View



Device Symbol



Top View
Device Schematic

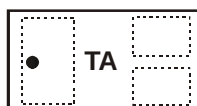
Ordering Information (Note 3)

Product	Marking	Reel size (inches)	Tape width (mm)	Quantity per reel
DSS2515M-7	TA	7	8mm	3,000
DSS2515M-7B	TA	7	8mm	10,000

- Notes:
1. No purposefully added lead.
 2. Diodes Inc's "Green" policy can be found on our website at <http://www.diodes.com>
 3. For packaging details, go to our website at <http://www.diodes.com>.

Marking Information

DSS2515M-7



Top View
Dot Denotes Collector Side

DSS2515M-7B



Top View
Bar Denotes Base and Emitter Side

TA = Product Type Marking Code

Maximum Ratings @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	15	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	15	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6	V
Collector Current - Continuous	I_C	500	mA
Peak Pulse Collector Current	I_{CM}	1	A
Peak Base Current	I_{BM}	100	mA

Thermal Characteristics

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Power Dissipation (Note 4) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	250	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 4) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$R_{\theta JA}$	500	$^\circ\text{C/W}$
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

Notes: 4. Device mounted on FR-4 PCB with minimum recommended pad layout.

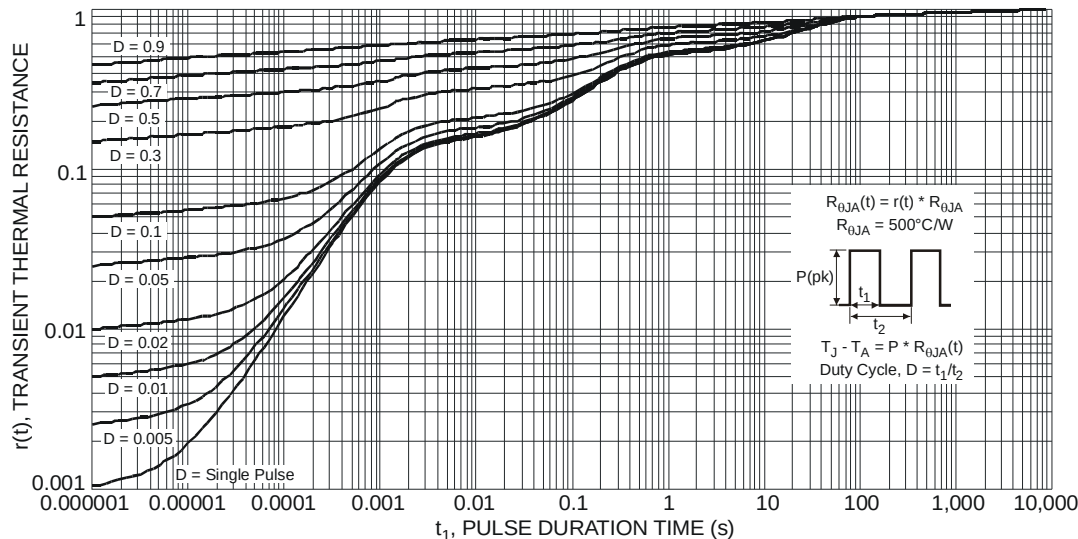


Fig. 1 Transient Thermal Response

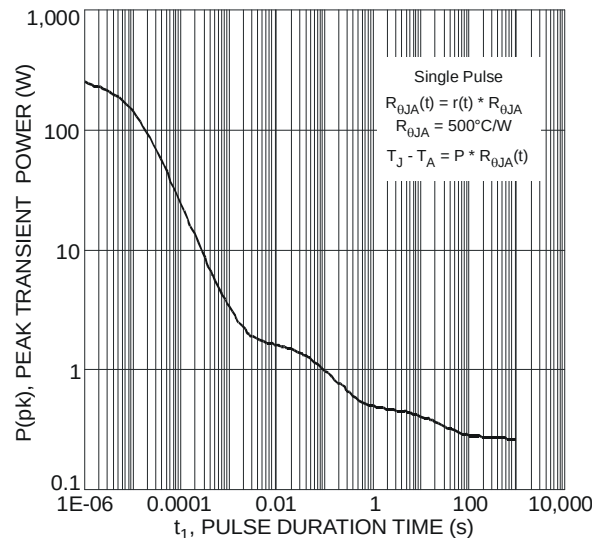


Fig. 2 Single Pulse Maximum Power Dissipation

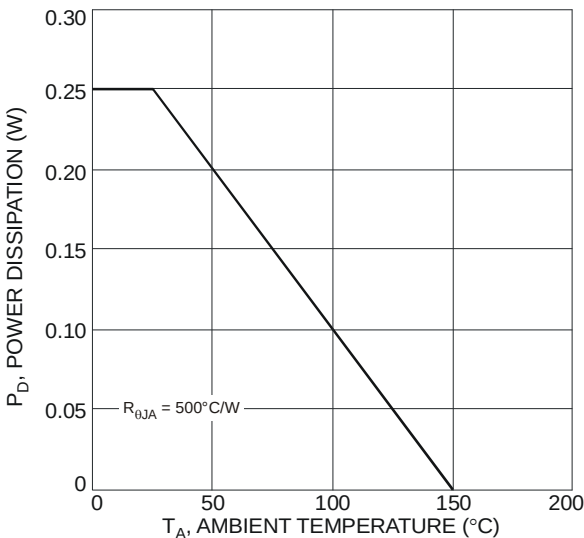


Fig. 3 Power Dissipation vs. Ambient Temperature (Note 4)

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
OFF CHARACTERISTICS						
Collector-Base Breakdown Voltage	BV _{CBO}	15	—	—	V	I _C = 100μA, I _E = 0
Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note 5)	BV _{CEO}	15	—	—	V	I _C = 10mA, I _B = 0
Emitter-Base Breakdown Voltage	BV _{EBO}	6	—	—	V	I _E = 100μA, I _C = 0
Collector Cutoff Current	I _{CBO}	—	—	100 50	nA μA	V _{CB} = 15V, I _E = 0 V _{CB} = 15V, I _E = 0, T _A = 150°C
Emitter Cutoff Current	I _{EBO}	—	—	100	nA	V _{EB} = 5V, I _C = 0
ON CHARACTERISTICS (Note 5)						
DC Current Gain	h _{FE}	200 150 90	— — —	— — —	—	V _{CE} = 2V, I _C = 10mA V _{CE} = 2V, I _C = 100mA V _{CE} = 2V, I _C = 500mA
Collector-Emitter Saturation Voltage	V _{CE(sat)}	— — —	— — —	25 150 250	mV	I _C = 10mA, I _B = 0.5mA I _C = 200mA, I _B = 10mA I _C = 500mA, I _B = 50mA
Collector-Emitter Saturation Resistance	R _{CE(sat)}	—	—	500	mΩ	I _C = 500mA, I _B = 50mA
Base-Emitter Saturation Voltage	V _{BE(sat)}	—	—	1.1	V	I _C = 500mA, I _B = 50mA
Base-Emitter Turn On Voltage	V _{BE(on)}	—	—	0.9	V	V _{CE} = 2V, I _C = 100mA
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS						
Output Capacitance	C _{obo}	—	—	6	pF	V _{CB} = 10V, f = 1.0MHz
Current Gain-Bandwidth Product	f _T	250	—	—	MHz	V _{CE} = 5V, I _C = 100mA, f = 100MHz

Notes: 5. Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300μs. Duty cycle ≤2%.

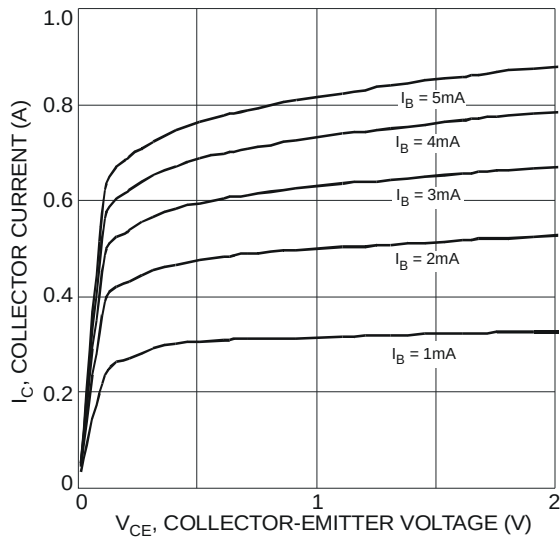


Fig. 4 Typical Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage

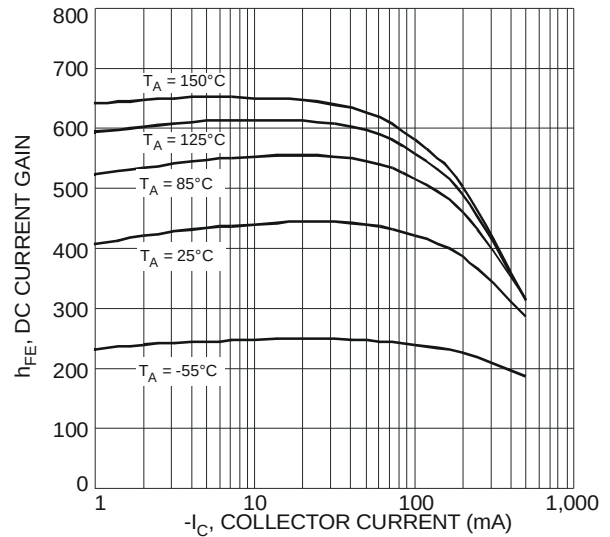


Fig. 5 Typical DC Current Gain vs. Collector Current

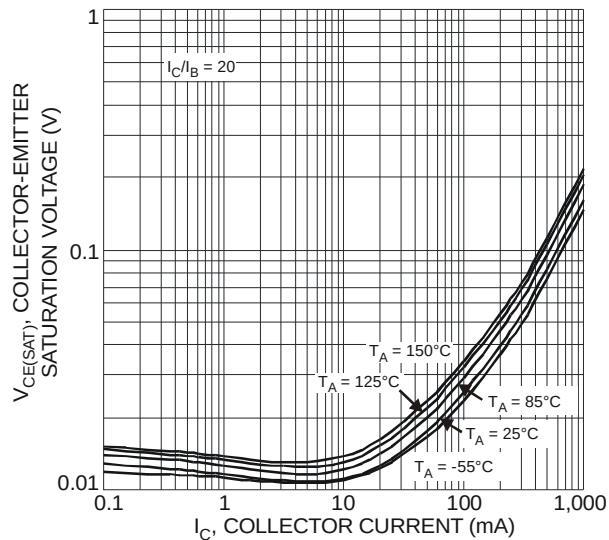


Fig. 6 Typical Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

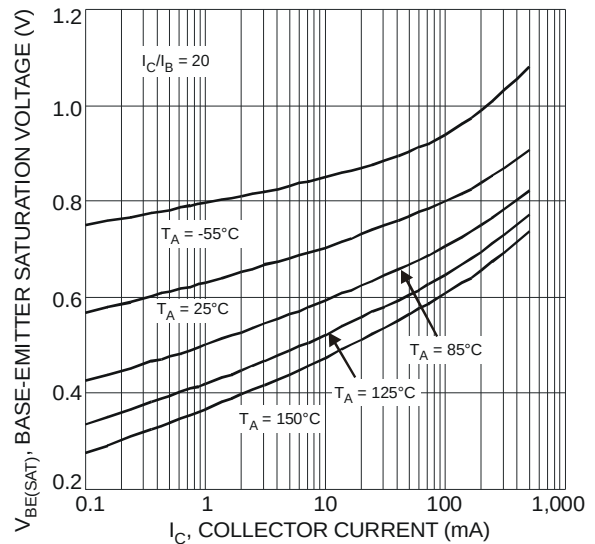


Fig. 7 Typical Base-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

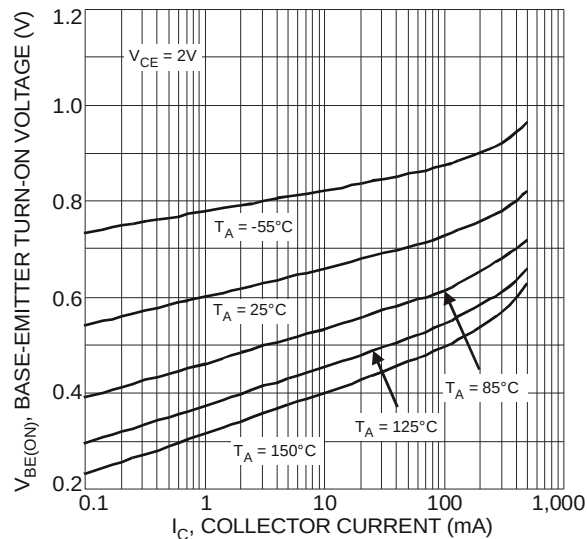


Fig. 8 Typical Base-Emitter Turn-On Voltage vs. Collector Current

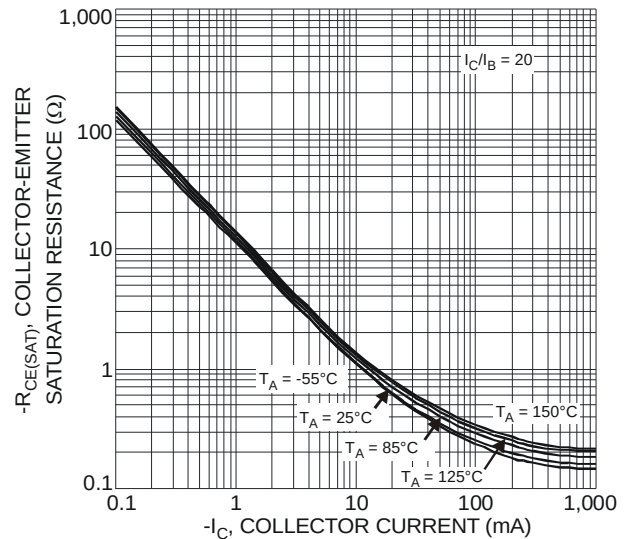
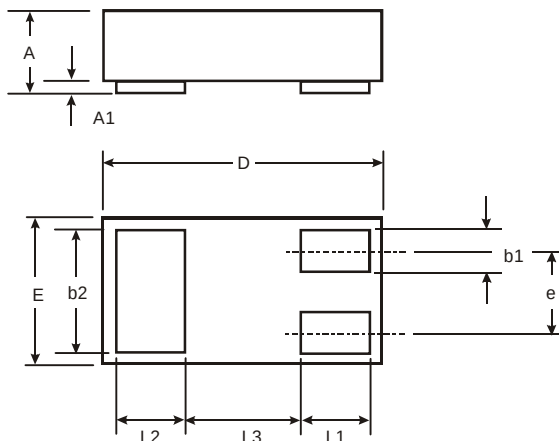


Fig. 9 Typical Collector-Emitter Saturation Resistance vs. Collector Current

Package Outline Dimensions



DFN1006-3			
Dim	Min	Max	Typ
A	0.47	0.53	0.50
A1	0	0.05	0.03
b1	0.10	0.20	0.15
b2	0.45	0.55	0.50
D	0.95	1.075	1.00
E	0.55	0.675	0.60
e	—	—	0.35
L1	0.20	0.30	0.25
L2	0.20	0.30	0.25
L3	—	—	0.40
All Dimensions in mm			

[illegible]

Dimensions	Value (in mm)
Z	1.1
G1	0.3
G2	0.2
X	0.7
X1	0.25
Y	0.4
C	0.7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9